

3月10日(火)				
会場	A会場 (3階第3会議室)	B会場 (3階第1会議室)	C会場 (3階第2会議室)	D会場 (3階第4会議室)
セッション	回路・実装設計技術&高速高周波・電磁特性技術1 座長:大島 心平 (小山工業高等専門学校)	材料技術 座長:	3D・チップレット技術1 座長:福島 晋史 (東北大学)	生成AI 実装技術1 座長:中上 京治 (ダイヤゼファ)
10:00	10A1-1 (0020) タイルめっき技術を用いたガラス基板上への平面型256GHzペンパシフスの実装 石田 涼馬 (九州大学)	10B1-1 (0026) 半導体パッケージ内に形成される異種結晶界面の安定化プロセス 長野 杜春 (ノーセミコンダクリューション)	10C1-1 (0003) TSV形成プロセスにおけるSi Deep Riepのマイクロテング効果 小島 龍人 (コネクタジャパン)	10D1-1 (0067) ジャンルアニメーション制作支援のための進化アルゴリズムに基づく背景生成手法 程 澤亨 (群馬大学)
10:15	10A1-2 (0105) 形状バリエーション検証に用いた有極型フィラメントフィルタに関する検討 和泉 虎太郎 (電気通信大学)	10B1-2 (0041) 市場分析から見る業界動向 青木 正光 (日本環境技術推進機構)	10C1-2 (0110) 三次元積層基板に向けた高アスペクト比5μm径TSV形成プロセス開発と電気特性評価 園田 康太郎 (熊本大学)	10D1-2 (0081) ジャンルアニメーション制作支援のための音階情報を用いたStable Video Diffusionの安定化手法 王 鈞 (群馬大学)
10:30	10A1-3 (0106) 橋脚構造によるストリップ線路を用いたカルデサック型フィルタの設計に関する検討 渡辺 詠午 (電気通信大学)	10B1-3 (0042) 銅導体を用いた銅ナノ粒子ペーストの低温接合 山脇 直也 (太陽日酸)	10C1-3 (0070) Chip on Waferプロセスによる、サブミクロン粒子のインパシメントを用いたUnderfill開封使用しない3Dコンソリダートデバイス構造 今泉 孝之 (ノーセミコンダクリューション)	10D1-3 (0037) ジャンルアニメーション制作支援における画像補間のための運動誘導拡散モデルの提案と実装 劉 豊理 (群馬大学)
10:45	10A1-4 (0075) 多周波無線システム向けのマイクロストリップフレックサの設計 徐 振豪 (電気通信大学)	10B1-4 (0052) 温度サイクルによるタイタチタンはんだ接合部の結晶方位変化 木村 翔星 (大阪大学)		10D1-4 (0047) 歩行リハビリテーションにおける計測の自動化と予測モデル構築に関する研究 石井 大地 (長野工業高等専門学校)
11:00	休憩 11:00~11:15 (15分)			
	回路・実装設計技術&高速高周波・電磁特性技術2 座長:五百旗頭 達吾 (岡山大学)	材料技術 座長:	3D・チップレット技術2 座長:安田 清和 (大阪大学)	生成AI 実装技術2 座長:中上 京治 (ダイヤゼファ)
11:15	10A2-1 (0121) 集中定数系子を用いたBPFと整合回路の統合設計 大島 心平 (小山工業高等専門学校)	10B2-1 (0064) 高温接合用途に向けたZnAl合金析出の結晶構造と高温引張特性の関係 高橋 晋 (鹿児島大学)	10C2-1 (0057) 水表面張力駆動による自己組織化実装を用いたHBM用ハイブリッド接合の界面解析 佐々木 潤太 (東北大学)	10D2-1 (0055) YOLOによる画像認識を用いた、自動車のインパルサー同一性のリアルタイム判定技術:交通誘導口への実装 孫 志剛 (群馬大学)
11:30	10A2-2 (0027) 多層基板上に構築したスプリング共振器を用いたQ値向上の検証 藤井 俊輔 (九州大学)	10B2-2 (0113) 動的パーコレーションに基づいたカーボンナノチューブ系導電性ペーストのインテグレーション制御 井上 雅博 (群馬大学)	10C2-2 (0115) ハイブリッド接合のためのフッ素干渉計を用いたボグフッ素解析と接合性評価 佐藤 達一 (東北大学)	10D2-2 (0056) YOLOによる画像認識のFaceNetによる顔人認識を組み合わせたリアルタイム顔人認識システム 林 秋茂 (群馬大学)
11:45	10A2-3 (0127) チップ素子, MSL, SiW構造を用いたトリプルパワの設計に関する検討 松木 淳一郎 (電気通信大学)	10B2-2 (0096) 半導体パッケージ回路検査用微細プローブ組立への銀微粒子結核結合の適用 福島 孝典 (群馬大学)	10C2-3 (0056) SiCN膜の膜質がハイブリッドボンディングに及ぼす影響 中田 涼平 (パナソニックホールディングス)	10D2-3 (0053) YOLOを用いた顔認識によるリアルタイム顔人認識の実装評価 白石 洋一 (群馬大学)
12:00	10A2-4 (0076) 可変インピーダンス変換器における位相制御電圧のシミュレーションと実測の整合性に関する検討 吉田 健人 (電気通信大学)		10C2-4 (0031) マテリアルズ・インフォマティクスと分子シミュレーションによる界面強度向上設計 岩崎 富生 (日立製作所)	10D2-4 (0046) 機械学習を用いた航空写真から的人物検出手法の検討 柳澤 陽成 (長野工業高等専門学校)
12:15	昼食 12:15~13:15 (60分)	B会場使用不可 12:00~13:35		
セッション	回路・実装設計技術&高速高周波・電磁特性技術3 座長:川上 雅士 (大阪工業大学)		サーマルマネジメント&パワーエレクトロニクス実装1 座長:嶋山 友行 (富山県立大学)	生成AI 実装技術3 座長:高橋 修司 (岡研)
13:15	10A3-1 (0025) 8GHz帯 円偏波UWBスロットアンテナの開発 本田 敬士 (九州大学)	第27回 有機/無機接合研究委員会 司会:山口 敦史 (パナソニックインダストリー) 13:30~14:20	10C3-1 (0007) コンポジット材料の熱伝導に寄与するh-BN二次粒子の熱伝導率評価手法の開発 松田 和幸 (三菱電機)	10D3-1 (0051) 雲み込みニューラルネットワークによるDC/DCコンバータの予測保全と組み込みシステムへの実装 TO TUAN ANH (群馬大学)
13:30	10A3-2 (0107) ストリップ線路とコプレーナ線路を用いたフィルタングラフナへの設計に関する検討 河野 通樹 (電気通信大学)		10C3-2 (0008) 3次元熱伝導率を考慮したTQFNおよびSiC/SiCモジュールのランダム化による熱伝導率評価方法構築 鈴木 幸 (新電元工業)	10D3-2 (0086) Raspberry Piを用いた、リアルタイム予測保全装置の実装とリアルタイム監視による精度の評価 進 浩 (群馬大学)
13:45	10A3-3 (0022) 反射角制御型メタマテリアルの構造設計と電波放射特性への応用 LI HAITAO (九州大学)	3D プリンタを利用した鉄鋼と樹脂の異材接合 田中 努 氏 (大阪産業技術研究所)	10C3-3 (0068) トポロジ最適化を用いた閥値変形形状最適化による熱抵抗低減ヒートシンク設計 洗井 勇吾 (パナソニックインダストリー)	10D3-3 (0019) 自動車用実用型マイクド設計のためのサグドモデル構築に関するユースケース研究, LSTM&L1/L2&Boostの精度評価 木村 将也 (群馬大学)
14:00	10A3-4 (0061) 第6世代移動通信システム用7GHz帯通電磁シールドの検討 佐藤 潤弥 (東京工芸大学)		10C3-4 (0135) 光チップレットに内蔵されたチップの放熱経路に関する考察 星野 雄基 (NTTデバイスロステクノロジ)	10D3-4 (0128) 自己組織化マップを用いた行人行動分類手法の検討 原田 創章 (長野工業高等専門学校)
14:15	休憩 14:15~14:30 (15分) 回路・実装設計技術&高速高周波・電磁特性技術4 座長:松浦 徹 (九州工業大学)	10B3-2 14:20~15:00	10C3-5 (0136) 光チップレットの冷却方法の検討 永永 朝朗 (NTTデバイスロステクノロジ)	10D3-5 (0083) プリント基板の電圧グラウンドプレーンの近傍電界分布と機械学習の分類技術の考察 奈良 茂夫 (A1&EMC研究所)
14:30	10A4-1 (0023) UHF帯CMOSエナジーハーベスタリング回路の設計 SUN YUCHEN (九州大学)	固体イオン交換法を採用したガラス内線析出現象の観察および評価 河野 美徳 氏 (千葉大学)	休憩 14:30~14:45 (15分)	
14:45	10A4-2 (0021) 地上放送放送, LTE, Wi-Fi対応 3D/4D共用差動型RFエナジーハーベスタリング回路の設計と実証 中瀬 浩七 (九州大学)		サーマルマネジメント&パワーエレクトロニクス実装2 座長:西村 秀孝 (富士電機)	生成AI 実装技術4 座長:岡 大輔 (DOWAハイテック)
15:00	10A4-3 (0073) 整流回路の AC モデルを使用した 2MHz 磁気結合共振 WPT システムのシミュレーション 菊地 秀雄 (群馬大学)	休憩 15:00~15:10 (10分) 第27回 有機/無機接合研究委員会 司会:渡辺 潤 (ONEKエレクトロニクス)	10C4-1 (0126) (仮)ロウイング・セラフィニエーザー周波数調整法によるDBC/AMB絶縁接合基板の界面熱伝導率測定 田中 浩平 (名古屋大学)	10D4-1 (0066) 交通流シミュレーションによる交通誘導ポートの信号時間制御ルール抽出方法の提案 周 日群 (群馬大学)
15:15	10A4-4 (0077) 複数のSDRの同期処理に関する検討 川上 雅士 (大阪工業大学)	10B4-1 15:10~15:50 工ボキ樹脂の硬化反応へのシリカフィラーの影響に関する解析 仲 啓志 氏 (東レリサーチセンター)	10C4-2 (0134) 絶縁NTCサーミスタによるパワーモジュールの高度な熱管理と信頼性評価 吉田 圭吾 (名古屋大学)	10D4-2 (0058) 物流倉庫自動化のためのデジタルツインにおける自律走行ロボットの経路経路決定とタタリ制御による最適化 泉 卓典 (群馬大学)
15:30	休憩 15:30~15:45 (15分) 回路・実装設計技術&高速高周波・電磁特性技術5 座長:室賀 翔 (東北大学)		10C4-3 (0116) 計測連携CAEによるパワーモジュールの動的な内部評価手法の検討 前澤 拓 (先端量子シミュレーション研究所)	10D4-3 (0018) Ultra-Wide Band無線システムにおける受信機配置最適化とKaimanFPGAによる実作業の位置推定精度の高精度化 井上 采都 (群馬大学)
15:45	10A5-1 (0120) 電磁シミュレーションを用いて基板の複素誘電率を推定する近似的な手法に関する検討 松浦 弘樹 (電気通信大学)	10B4-2 15:50~16:30 高信頼性アンダーフィル材開発に向けた内部バズミを用いた寿命評価アプローチ 吉田 拓弥 氏 (ナミックス)	10C4-4 (0090) 金薄膜転写により平滑化したダイヤモンド基板と窒化ガリウムチップの大気中常温接合 後藤 慎太郎 (東北大学)	10D4-4 (0098) 深層強化学習を用いた自律移動制御のためのネットワーク構造の検討 大 直 嗣 (長野工業高等専門学校)
16:00	10A5-2 (0033) バイオマス由来材料の適用にプリント記録における高周波伝送特性の評価と信号伝送品質の検証 宮川 幸司 (三菱電機)		10C4-5 (0059) ダイヤモンドはんだ接合における垂直界面増加の非破壊観察 林 雄二 郎 (理化学研究所)	10D4-5 (0131) 変分オートエンコーダを用いたマイクロバヨーム形成工程の相關関係の推定 岸 知広 (長野工業高等専門学校)
16:15	10A5-3 (0050) DDR4 Fly-by-tiltプロセスにおけるツイスト型スタック増幅配線が波形品質に与える影響 溝本 信朗 (日立製作所)			
16:30	10A5-4 (0093) 超広帯域双方吸収コンモードフィルタの設計と波形の測定 成島 尊太 (電気通信大学)			
16:45				

3月11日(水)						
会場	A会場 (3階第3会議室)	B会場 (3階第1会議室)	C会場 (3階第2会議室)	D会場 (3階第4会議室)		
セッション	マイクロメカトロニクス実装技術1 座長:森田 伸友 (産業技術総合研究所)	回路・実装設計技術&高速高周波・電磁特性技術6 座長:松崎 徹 (九州工業大学)	光回路実装技術1 座長:竹崎 元人 (白山)	MES2025受賞講演 座長:柏木 行康 (大阪産業技術研究所) MES2025論文委員長		
時間						時間
10:00	11A1-1 (0016) 信頼性に優れたタイミングのためのノア層結晶の破壊:および 銅柱 子添加の効果 Gallegos Alessandra (京都先端科学大学)	11B1-1 (0049) 箱型ハードウェアのコンモンモードノイズに重畳したサイドチャネル情報漏洩メカニズムの考察 五井旗順 健吾 (岡山大学)	11C1-1 (0099) Co-packaged optoelectronic技術への応用に向けたエスケーパによるリレー-導波路型デジタルバックカプの構成と伝送率の最適化 中島 陽壽 (鹿屋義塾大学)	11D1-1 (0142) 【研究奨励賞】 微細な高速データ数モデルを用いた超軽量電波吸収体における電磁特性の推定に関する検討 鈴木 暖 (東北大学)		10:00
10:15	11A1-2 (0035) AI/NI 発熱反応におけるミスマッチひずみ駆動湾曲変形とその接合応用 ATHICHAKHONGHAT Sarankamol (京都先端科学大学)	11B1-2 (0071) 半導体IC内のEMITモデル化手法適用と精度検証 高木 玲蘭 (東芝デバイス&ストレージ)	11C1-2 (0043) 高環境耐性を有するシリングモードポリマ-光導波路の開発 谷内 冬馬 (住友ベークライト)	11D1-2 (0143) 【研究奨励賞】 ポリマ-光導波路の損失低減化にむけた形状設計 佐々木 こと (京セラ)		10:15
10:30	11A1-3 (0124) QCMによる水中揮発性脂肪族量子ナノデバイスの開発-長時間測定における周波数ドリフト評価-(仮) 下田 楓大 (東京大学)	11B1-3 (0088) 大電力SiCにおける電源供給ネットワークの電流密度均等化手法:バックゲート設計最適化のアプローチ 高橋 成正 (Jソシオキャスト)	11C1-3 (0095) シリコンフォトニクス埋め込み技術を用いた光電集積パッケージの開発 上村 紘崇 (京セラ)	11D1-3 (0144) 【研究奨励賞】 冷却速度と高温放散がSn-3.0Ag-0.5Cuはんだの組織と硬度に及ぼす影響 村田 夢実 (大阪大学)		10:30
10:45	11A1-4 (0103) 不織布を基材とした表面増強ラマン-散乱基板を用いたアルビド光検出システムの開発 横合 拓巳 (高松大学)	11B1-4 (0078) 設計初期段階における給電用ワイヤ-パネスを模擬した解析モデルの検討 川上 雅士 (大阪工業大学)	11C1-4 (0111) 空冷条件下における+21dBm×16チャンネルCWDM ELSFPMシミュレーションの光出力特性 白石 勇希 (古河電気工業)	11D1-3 (0145) 【研究奨励賞】 接着剤/ポリマ-実装技術による皮膚貼付型角度センサの開発 高桑 聖仁 (東京大学/理化学研究所)		10:45
11:00	休憩 11:00~11:15 (15分)					
	マイクロメカトロニクス実装技術2 座長:竹内 魁 (東北大)	回路・実装設計技術&高速高周波・電磁特性技術7 座長:若生 直樹 (電磁技術研究所)	光回路実装技術2 座長:木下 遼太 (住友ベークライト)	休憩 11:00~11:10 (10分) MES2025受賞講演(各20分) 座長:柏木 行康 (大阪産業技術研究所)		
11:15	11A2-1 (0015) MEMS技術を用いたシリコン製ペーパーチャンバの作製 柳澤 直輝 (産業技術総合研究所)	11B2-1 (0123) 超軽量電波吸収体を用いたシールド筐体開口部からの漏洩電磁界抑制効果 室賀 翔 (東北大学)	11C2-1 (0153) 【依頼講演】 大畠 伸夫 氏 (三菱電機)	低温Cu-Cu接合用酸溶銅めっき添加剤 神楚 大軌 (奥野製薬工業)		
11:30	11A2-2 (0074) O ₂ プラズマ処理と低温加熱を組み合わせたAuの表面活性化による大気中常温接着接合 松延 晃生 (九州大学)	11B2-2 (0132) 抄紙プロセスを用いたガラス繊維およびCNT複合電波吸収体の試作と評価 根本 純司 (北越コ-ポレーション)		11D2-2 (0147) 【ベストペーパー賞】 電気アスチンによるAS052/C1020の高信頼性接合法の検討		
11:45	11A2-3 (0105) 活性性原子層を介したSi/Cuの常温接合 山内 峻平 (九州大学)	11B2-3 (0118) カーボンナチューを用いた超軽量電波吸収材料の材料設計手法に関する検討 鈴木 暖 (東北大学)	11C2-2 (0100) 浸漬冷却システム用シリングモード多芯拡大ビームネットワークの開発 アレクサンダー・ウィリアム・セザンツフ・ラ (白山)	11D2-3 (0148) 【ベストペーパー賞】 銀シードセミアナログ法によるBUF上への微細銅配線形成		
12:00	11A2-3 (0140) 表面活性化常温接合により形成されたInP/SiC接合界面 中村 潤平 (九州大学)	11B2-4 (0108) ちみ飛渡を複合した電磁ノイズ抑制シートにおけるフル特性の制御に関する検討 鎌野 瑛斗 (東北大学)	11C2-3 (0138) 超小型シリコンフォトニクス光トランシーバの長期油浸冷却環境における動作検証 武藤 隆 (アイオー)	11D2-4 (0149) 【ベストペーパー賞】 Cu-Si ₃ N ₄ 絶縁回路基板の接合界面評価		
12:15		11B2-5 (0032) ノイズ抑制シートの測定再現性の改善とグラフェンノイズ抑制シートの評価 吉田 信 (シードテック)	11C2-4 (0150) 石英系光導波路技術で進化する多機能ガラス基板 片崎 里美 (NTT)	11D2-4 (0149) 【ベストペーパー賞】 Cu-Si ₃ N ₄ 絶縁回路基板の接合界面評価 眞 裕章 (大阪大学)		
12:30	昼食/ポスターセッション・企業展示・アカデミック展示 コアタイム 12:30~14:15 (105分)					
	11P3 (3階ホワイエ) ポスターセッション (15所属) 3/12 ショートプレゼン					
	A 11P3-01 (0014) 球形透明反射スクリーンを用いた空中映像表示システムMirage:とその応用	阪本 邦夫 (甲南大学)				SP1
	B 11P3-02 (0133) 豚生体を対象とした生体通信ネットワーク用ウェアラブル電極が作る表面電流分布解析	横山 真心 (東京工芸大学)				SP2
	C 11P3-03 (0029) アルミ互層多層基板	神山 孝一 (メイコム)				
	D 11P3-04 (0085) 無電解めっき用電着フォトリソ	丸田 博之 (シミズ)				
	E 11P3-05 (0129) エレキCADを使ったFPGA回路設計・検証	松澤 浩彦 (図研)				
	F 11P3-06 (0013) 先端半導体パッケージ向け厚膜ドライフィルムレジストの開発	岸野 真之 (旭化成)				
	G 11P3-07 (0028) レーザ-刺激用依着接着剤の開発	内田 一幸 (日鉄ケミカル&マテリアル)				
	H 11P3-08 (0034) Sn-37.5mass%Bi合金の超塑性変形に及ぼす複合添加の影響	佐藤 成雄 (群馬工業高等専門学校)				SP3
	I 11P3-09 (0045) Sn-Bi合金の超塑性に及ぼす組成と添加元素の影響	堀江 七祐 (群馬工業高等専門学校)				SP4
	J 11P3-10 (0117) 銅積層アルムの銅積層とガス透過性に関する検討	倉田 吉太郎 (東レ)				
	K 11P3-11 (0006) 半導体/金属界面の接触抵抗の精密計測によるデバイス構造最適化	桂 卓樹 (京都工芸繊維大学)				SP5
	L 11P3-12 (0084) Cu/SiO ₂ /アブリッドボンディングの活性化における素外線処理と真空プラズマ処理の比較	Wu Kejun (ウソエ電機)				
	M 11P3-13 (0072) 無電解Co-Wめっきの車載用放熱部品への適用可能性検討	菅原 彩 (愛知製鋼)				
	N 11P3-14 (0024) アルカリ水溶液を用いたリチウムイオン二次電池の発火無効化装置の開発	佐藤 隆 (東京工業大学)				SP6
	O 11P3-15 (0109) 大電力宇宙電機推進の研究開発に供する複機能作動実験設備の構築ー スラスタ並列作動実験 ー	藤原 理央 (東京工芸大学)				SP7
	11T3 (1階展示室B) 企業展示・アカデミック展示 (24所属) ※3月12日の12T3と同様※					
14:15	11T4-1 表彰式 展示室A 司会: 高橋 文博 実行委員長 (拓殖大学) MES2025受賞 ベストペーパー賞: 4件 研究奨励賞: 5件、ポスターワード: 2件 会長挨拶 組織委員長挨拶、大会事業委員長より学会イベント紹介					
15:00	休憩 15:00~15:15 (15分)					
15:15	11T5-1 (0154) 特別講演① 展示室A 司会:室賀 翔 プログラム委員長 (東北大学)、紹介:森 裕幸 組織委員長 (日本アイ・エム) 「小型省陸実証機SLIMの成果とエレクトロニクス技術」 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 教授 福田 盛介 氏					
16:15	休憩 16:15~16:30 (15分)					
16:30	11T6-1 (0155) 特別講演② 展示室A 司会:室賀 翔 プログラム委員長 (東北大学)、紹介:森 裕幸 組織委員長 (日本アイ・エム) 「ICチップのセキュリティに向けたパッケージと回路技術の進化」 神戸大学大学院 科学技術イノベーション研究科 教授 永田 真 氏					
17:30	移動 17:30~18:00 (30分)					
18:00	交流会 モータウンバグダッドカフェ王子 (the b) 司会: 西井 佑輔 実行副委員長 (奥野製					

3月12日(木)					
会場	A会場 (3階第3会議室)	B会場 (3階第1会議室)	C会場 (3階第2会議室)	D会場 (3階第4会議室)	
セッション	電子部品・実装技術 座長：甲斐 岳彦 (太陽誘電モビリティテクノロジー)	チュートリアル講演 司会：八南 公彦 明彦 (よこはま高度実装技術コンソーシアム)	最先端めっき実装技術 座長：藤波 知之 (EEJA)	プリンタブル・フキシプル・バイオエレクトロニクス・ウェアラブル応用・ヘルスケア応用1 座長：野村 健一 (産業技術総合研究所)	
時間	12A1-1 (0094) Sn-3.0Ag-0.5Cuはんばい接合における高導電環境下での金属間化合物の成長挙動調査 村田 夢実 (大阪大学)	12B1-1 (0009) 10:00~10:30 電子回路実装技術の役割、将来と人材 羽深 等 氏 (横浜国立大学)	12C1-1 (0062) ガラス基板上への高密度無電解銅めっきプロセス 有清 恵太 (奥野製薬工業)	12D1-1 (0102) 応力緩和挙動に着目したストレッチャブル配線の電気特性変動解析 岡村 春弥 (群馬大学)	
10:15	12A1-2 (0119) 防水性能を有したコーティング剤による電子回路基板信頼性向上 酒井 規光 (白昼自動車)	12B1-2 (0010) 10:30~11:15 司会：羽深 等 (横浜国立大学)	12C1-2 (0089) 樹脂およびガラス基板上における銅ナノ粒子をシート層としためっき回路形成技術の開発 有村 英徳 (石原ケミカル)	12D1-2 (0039) 金-ポリウレタン伸縮性ナノメッシュ電極の開発と心筋シートへの応用 阿部 大和 (東京大学)	
10:30	12A1-3 (0004) 結晶構造解析を用いた多相構成体の超音波検出における条件適正化手法の実験的検討 伊藤 宣司 (東芝)	12B1-2 (0010) 10:30~11:15 司会：羽深 等 (横浜国立大学)	12C1-3 (0) 微細配線対応シード層エッチングプロセス 三田 桓斗 (JCU)	12D1-3 (0082) 直接描画型3次元印刷による伸縮性エレクトロニクスの開発 山岸 健人 (東京農工大学)	
10:45	12A1-4 (0001) Si深堀加工技術を用いた転写可能なAu粒子ハブ 藤野 品仁 (田中貴金属工業)	どよりも分がらひアプリント配線板、サブストレイト、インターポーザーの配線技術 八南 公彦 明彦 氏 (よこはま高度実装技術コンソーシアム)	12C1-4 (0) 亜硫酸銀系めっき皮膜に対する高硬度化の検討 宮永 誠市 (日進化成)	休憩 10:45~11:00 (15分) プリンタブル・フキシプル・バイオエレクトロニクス・ウェアラブル応用・ヘルスケア応用2 座長：柏木 行雄 (大阪産業技術研究所)	
11:00	休憩 11:00~11:15 (15分) ※各2名、質疑応答なし 司会：木下 貢太郎 (住友ベークライト)		休憩 11:00~11:15 (15分) 環境調和型実装技術 座長： 桂 幸祐 (京都工芸繊維大学)	12D2-1 (0005) レーザー誘起プラズマと金属酸化物を重合した高導電・高信頼性なガラスセラミックスの開発 桂 幸祐 (京都工芸繊維大学)	
11:15	12A2-1 SP1~SP7 ポスター学生によるショートプレゼン 座長：野口 祐智 (三条市立大学)	休憩 11:15~11:30 (15分) チュートリアル講演 司会：宮代 文夫 (よこはま高度実装技術コンソーシアム)	12C2-1 (0151) 【依頼講演】 Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene sulfide)を配合することによるプリント配線板の難燃性、信号伝達の向上 伊藤 大祐 氏 (ダイセル)	12D2-2 (0036) ボロン酸ナリ界面形成技術を活用したがん検出技術への応用 堀口 諭吉 (産業技術総合研究所)	
11:30	休憩 11:30~11:45 (15分) 検査技術 座長：野口 祐智 (三条市立大学)	12B2-1 (0112) 11:30~12:15 電子機器の高密度化、応用拡大で半導体・配線板構造が変わる！ 本多 進 氏 (サーキットネットワーク)	12C2-2 (0152) 【依頼講演】 LC-MS/MSを用いためっき皮膜中のPFAS測定技術の開発 今若 直人 氏 (鳥取県産業技術センター)	12D2-3 (0114) 高齢者利用のためのAI搭載ウェアラブル機器間の人体通信における体表表面電流分布の電磁境界解析 北山 哲也 (東京工芸大学)	
11:45	12A3-1 (0101) TDC 組込み型パワースイッチの遅延付加経路選択回路の設計 山根 吉志 (徳島大学)	電子機器の高密度化、応用拡大で半導体・配線板構造が変わる！ 本多 進 氏 (サーキットネットワーク)	12C2-2 (0152) 【依頼講演】 LC-MS/MSを用いためっき皮膜中のPFAS測定技術の開発 今若 直人 氏 (鳥取県産業技術センター)	12D2-3 (0114) 高齢者利用のためのAI搭載ウェアラブル機器間の人体通信における体表表面電流分布の電磁境界解析 北山 哲也 (東京工芸大学)	
12:00	12A3-1 (0125) 温度補正オフセットキャンセル型コンパレータを用いるチップ間配線検査容易化設計 大森 陽斗 (徳島大学)				
12:15	12A3-1 (0125) 温度補正オフセットキャンセル型コンパレータを用いるチップ間配線検査容易化設計 大森 陽斗 (徳島大学)				
12:30	昼食/ポスターセッション・企業展示・アカデミック展示 コアタイム 12:30~13:45 (75分)				
	12P3 (3階ホワイエ) ポスターセッション (15所席) ※3月11日の11P3と同様※				
	12T3 (1階展示室B) 企業展示・アカデミック展示 (24所席)				
	① 奥野製薬工業株式会社 ② 株式会社ツプロロジック ③ 丸元株式会社 ④ 田中貴金属工業株式会社 ⑤ ソーセコダクタリオンシステム株式会社 ⑥ 株式会社電機製作所	⑦ 株式会社サモグラフィクス ⑧ 東北大学 半導体クオリティバディ(S+Hub) ⑨ 株式会社電気印刷研究所 ⑩ ハニー化成株式会社 ⑪ カガク株式会社 ⑫ キーサイトテクノロジー株式会社	⑬ 日機株式会社 ⑭ ティー・エイ・インストルメント・ジャコ株式会社 ⑮ MI-6株式会社 ⑯ 株式会社日立ハイテック ⑰ サムロック株式会社 ⑱ サイバネットシステム株式会社	⑲ 株式会社先端力学シミュレーション研究所 ⑳ JFEテクノリサーチ株式会社 ㉑ 大塚電子株式会社 ㉒ 株式会社回研 ㉓ ウォイド電機株式会社 ㉔ NTT株式会社 ㉕ 三菱ガス化学株式会社	
セッション	技術委員会のご紹介 司会：技術調査委員会委員長	チュートリアル講演 司会：宮代 文夫 (よこはま高度実装技術コンソーシアム)	配線板・パッケージ基板・部品内蔵技術1 座長：佐藤 敦子 (ナミックス)	信頼性解析技術1 座長：廣畑 賢治 (東芝)	
時間	12A4-1 ・検査技術委員会：内山 浩志委員長 ・部品内蔵技術委員会：加藤 義尚委員長	12B4-1 (0137) 13:45~14:30 光データ通信のための光実装技術、CPOへの期待 平 洋一 氏 (慶應義塾大学)	12C4-1 (0139) 【依頼講演】 I E C国際標準規格「積層三次元電子モジュール」の評価方法について 小島 智 氏 (コマメディアデザインオフィス)	12D4-1 (0030) 熱変形・熱画像データを用いた基板反りCAE解析精度の向上 萩 康雄 (エヌベック)	
14:00			12C4-2 (0079) 埋め込みキャパシタ基板のグラッドリテンパンスST特性の評価 立岡 淳 (三井金属)	12D4-2 (0136) リフロー実装に対応するはんだ付け性の試験前処理の検討 泉水 崇彰 (TDK)	
14:15			12C4-3 (0087) 高電圧化によるソルダレジストの絶縁信頼性への影響 安藤 雅徳 (太陽インキ製造)	12D4-3 (0087) 高電圧化によるソルダレジストの絶縁信頼性への影響 安藤 雅徳 (太陽インキ製造)	
14:30		休憩 14:30~14:45 (15分) チュートリアル講演 司会：本多 進 (サーキットネットワーク)	12C4-3 (0097) 部品内蔵型Si-MOSFETパッケージにおけるレザードライブ電圧・熱特性および接続信頼性へ及ぼす影響 林 祐太郎 (東芝デバイス&ストレージ) 城 敦士 (大阪大学)	12D4-4 (0122) はんばい接合部エレクトロミグレーション挙動の理解に向けたその場観察手法の検討 城 敦士 (大阪大学)	
14:45		12B5-1 (0141) 14:45~15:30 設計に活かすMLCC最新動向・小型高密度実装と技術革新・ 武藤 弘樹 氏 (村田製作所)	休憩 14:45~15:00 (15分) 配線板・パッケージ基板・部品内蔵技術2 座長：佐藤 敦子 (ナミックス)	信頼性解析技術2 座長：廣畑 賢治 (東芝)	
15:00	調整中		12C5-1 (0044) MLCC焼成時のプリント配線板に対する炭化範囲調査 大國 正 (日産自動車)	12D5-1 (0012) EBSD解析を用いたはんだ疲労劣化量化による液相試験法活用の考察 西森 久雄 (トヨタ自動車)	
15:15			12C5-2 (0002) TGXガラスの洗浄性に及ぼす洗浄液の表面張力の影響 西原 弘明 (パーカー・ホールショーン)	12D5-2 (0065) 鉛フリー高温溶接材料であるZnAl合金を用いた微小接合試験片の疲労強度評価 木村 健一 郎 (鹿児島大学)	
15:30		12B5-2 (0054) 15:30~16:15 Chipletはど進むか？ 宮代 文夫 氏 (よこはま高度実装技術コンソーシアム)	12C5-3 (0048) 熱ナノインプリントノゾグラフィによる微細線形形成の熱硬化性樹脂への適用 飯原 達介 (北海道科学大学)	12D5-3 (0080) 環境試験下におけるn型熱電材料(Bi2Te3)と銀熱結合金の信頼性 郷原 周向 (京都工芸繊維大学)	
15:45			12C5-4 (0017) ポリプロピレンを使用した低損失プリント配線板の開発 渡辺 匠史 (岡山県工業技術センター)	12D5-4 (0092) 半導体パッケージの熱応力環境下でのチップラック評価手法技術 阿部 慶樹 (東芝デバイス&ストレージ)	
16:00			12C5-5 (0038) 印刷技術で実現する高品質100GHz帯周波伝送路 渡辺 透路 野村 健一 (産業技術総合研究所)	12D5-5 (0063) 3次元異種材料接合界面部から、熱疲労によるき裂の進展形状の予測 村松 大地 (鹿児島大学)	
16:15					

- ・一般発表: 119件
- ・特別講演: 2件
- ・依頼講演: 4件
- ・受賞講演: 8件
- ・有機無機: 4件
- ・チュートリアル: 6件

} 143件

- ・ポスター: 15件 (学生SP: 7件)
- ・企業展示: 25件 (展示: 23社)
- ・アカデミック展示: 1件